

# 李康

西门子电子工业软件公司

✉ kang.li@siemens.com

🌐 www.kangli.me



## 专长

图形渲染	基于物理之渲染 (PBR), 虚拟/增强现实 (VR/AR)
CAD/CAM/CAE	3D打印, 形状/拓扑优化, 有限元/边界元, 等几何分析
几何建模	B-Rep (Parasolid), NURBS, 多边形网格, 点云
人工智能	统计形状模型, 机器学习, 计算机视觉

## 经验

西门子电子工业软件公司 - 软件工程师	2015年07月~现在
◦ 软件维护: Teamcenter底层Direct Model渲染引擎, JT格式, Parasolid支持	美国爱荷华州
◦ 基于物理之渲染(SVM), B-Rep(ULP/趋同建模), WebAssembly (UPCS)	
西门子美国研究院 - 研发实习生	2014年06月~2014年08月
◦ 利用NX Open与Parasolid实现Siemens NX中3D打印方向优化的算法	美国新泽西州
伊利诺伊理工大学 - 研究助理	2009年01月~2015年05月
◦ 发表5篇杂志和4篇会议论文并获4个最佳论文奖	美国芝加哥

## 教育

伊利诺伊理工大学	2009年01月~2015年05月
博士(机械工程)	美国芝加哥
同济大学	2001年09月~2008年03月
硕士(机电一体化), 学士(机械设计制造及其自动化)	上海

## 技能

编程	C/C++, MATLAB, FORTRAN; OpenGL, NX Open, Parasolid Visual Studio, Xcode; LaTeX, HTML/CSS
软件	NX, Teamcenter Visualization, Pro/E, Solidworks, Rhino3D, AutoCAD, Mimics; Abaqus, ANSYS, COMSOL, Hypermesh; Geomagic; Photoshop, Illustrator

## 奖项

Prakash Krishnaswami CAPPD 最佳论文奖	2014年08月, 2012年08月, 2010年08月
ASME IDETC/CIE 会议	美国水牛城, 芝加哥, 加拿大蒙特利尔
最佳论文一等奖	2011年10月
SIAM/ACM GD/SPM 联合会议	美国奥兰多

## 专利与论文

- ▷ “轻量精确三维可视化格式的系统与方法” 美国专利公开于2019年11月
- ▷ “增量制造 (3D打印) 的成形方向” 美国专利公开于2016年03月
- ◇ “统计形状建模中基于微分同胚重参数化的形状特征对应优化”. *Computer-Aided Design* 期刊, 2015年
- ◇ “一组形状的协方差矩阵: 样条曲线的故事”. *Computers & Graphics* 期刊, 2015年
- ◇ “服务远程制造的直接几何加工”. *Computing & Information Science in Engr.* 期刊, 2012年
- ◇ “基于边界积分的等几何分析及形状优化”. *Computer-Aided Design* 期刊, 2011年
- ◇ “具有增强拓扑特性的MLS曲面之切片法”. *Computing & Information Science in Engr.* 期刊, 2011年